平成 29 年 6 月 14 日

各　　位

会 社 名　　株式会社フェローテックホールディングス
代表者名　　代表取締役社長　　山村　　章
（ＪＡＳＤＡＱ･コード６８９０）
問合せ先　　取締役経営企画担当　　若木　啓男
（０３-３２８１-８１８６）

半導体ウエーハ事業における製造、販売体制に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月に世界第 3 位の大手半導体ウエーハ製造・販売会社である台湾の GlobalWafers Corporation 社（以下「GWC 社」といいます。）との間で、業務提携に係る基本覚書を締結し、今日に至るまで同社の協力の下、中国国内における半導体ウエーハの生産体制、販売体制の構築を進めてまいりました。 この度、当社中国工場における 8 インチウエーハ製造の生産体制構築の目途が付いてきたことに伴い、本提携並びに当社の半導体ウエーハ事業の製造、販売体制についてお知らせいたします。

１．業務提携の趣旨

当社では、100%子会社である上海申和熱磁電子有限公司（以下「上海工場」といいます。）において、従来より、小口径ディスクリート半導体ウエーハの製造・販売を行っておりますが、昨今の中国国内の半導体ウエーハ需要の拡大、及び中国政府の重要政策である「中国製造 2025」による国内生産推進策㊟に対応し、昨年より半導体ウエーハ製造ビジネスの強化を図ってまいりました。具体的には、現在の取扱製品である小口径（6 インチ以下）ウエーハに加えて、新たに 8 インチ（200㎜）半導体ウエーハの生産、販売を開始すべく、昨年より、当社銀川工場に隣接して結晶引上の専用工場の建設に着手しており、本年 7 月の竣工を目指しております。また、ウエーハ加工については、上海工場に加工専用ラインを新設するなどにより、生産体制の構築に鋭意注力しております。このような中で、当社としては、半導体メーカーからの旺盛なウエーハ需要に応える為に、生産体制の早期確立と高度な技術力の確保が急務と考え、当社の既存取引先である GWC 社から生産体制の立ち上げと技術面の支援を得ることが最良と判断しました。なお、GWC 社との業務提携の内容としては、主に①中国市場を主な対象地域とする独占販売とマーケティングの合弁販売会社（上海葛羅禾半導体科技有限公司（2016 年 5 月設立））の設立、②当社 8 インチウエーハ製造投資に係る GWC 社からの技術支援、③当社製造の 8 インチウエーハの合弁販売会社への独占供給を基本とするものであります。

当社としては、本年度第 2 四半期より稼働を開始し、年内に月産 15 万枚の生産体制に移行していく予定です。また、次の段階では、引き続きこの合弁販売会社を通じての販売を継続しながら、さらに月産 30 万枚の生産体制を整え、将来的には月産 45 万枚の生産体制の構築を目指して参ります。本提携により、GWC 社が持つ半導体ウエーハ製造における高度な技術力と当社の最新の半導体ウエーハ製造設備を備えた生産拠点並びに顧客基盤が組み合わさることで、中国における最良の半導体ウエーハソリューションプロバイダーとしての地位確立に資するものになります。

注）　現状、中国は、半導体ウエーハのほとんどを海外からの輸入に依存しております。　その為、中国政府としては、自国での調達率を 2025 年までに 50%へ引き上げるべく増産体制づくりの政策を進めており、今後数年間で 1,610 億米ドル（約 18 兆円）を半導体産業の強化に投入すると発表しております。

2. 業務提携の相手先の概要

（1）	名称	Global Wafers Corporation（環球晶圓股份有限公司）	
（2）	所在地	新竹市科学工業園区工業東二路８号	
（3）	代表者の役職・氏名	董事長(会長)：徐秀蘭、総経理(社長)：Mark England	
（4）	事業内容	半導体インゴット及びウエーハの開発、設計、製造、販売	
（5）	資本金	43.7億台湾ドル	
（6）	設立年月日	2011年10月1日	
（7）	大株主及び持株比率	Sino-American Silicon Products Inc.　50.8%　(2016年4月現在)	
（8）	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当なし
		人的関係	該当なし
		取引関係	半導体小口径ウエーハの受託加工、坩堝の販売
		関連当事者への該当状況	該当なし

（9） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（単位:百万台湾ドル、円表示は1台湾ドル=3.65円で換算）

決算期	平成26年12月期	平成27年12月期	平成28年12月期
連結純資産	NT$13,201 (48,183百万円)	NT$16,725 (61,046百万円)	NT$15,819 (57,739百万円)
連結総資産	NT$21,385 (78,055百万円)	NT$23,816 (86,928百万円)	NT$60,560 (221,044百万円)
連結売上高	NT$15,922 (58,115百万円)	NT$15,310 (55,881百万円)	NT$18,427 (67,258百万円)
連結営業利益	NT$2,336 (8,526百万円)	NT$2,685 (9,800百万円)	NT$1,378 (5,029百万円)
連結経常利益	NT$2,679 (9,778百万円)	NT$2,808 (10,249百万円)	NT$1,344 (4,905百万円)
連結当期純利益	NT$2,095 (7,646百万円)	NT$2,044 (7,460百万円)	NT$939 (3,427百万円)
１株当たり連結当期純利益	NT$6.6 (24.0円)	NT$5.8 (21.1円)	NT$2.5 (9.2円)
備考	GWC社は、台湾の中美矽晶股份有限公司（Sino-American Silicon Products Inc.）の半導体事業部門が独立して2011年10月に設立。その後2008年に米国のウエーハメーカーのGlobiTech Inc.を買収して以降、 2012年4月に、コバレントマテリアル(株)(旧東芝セラミックス)からシリコンウエーハ事業、2015年にデンマーク半導体ウエーハメーカーのTopsil、2016年12月には米国大手半導体ウエハーメーカーのSun Edison Semiconductorを買収する等、M&Aにより業容を急拡大し、現在、世界第3位の半導体ウエーハメーカーに成長しております。		

3. 今後の見通し

当社の平成30年3月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以　上